



RU8-160-25-SE-L-DV-BL

HSC8-050-02-19-DP

(0.80 mm) .0315"

RU8, HSC8 SERIES

HIGH-SPEED RISER CARD KIT

SPECIFICATIONS

For complete specifications and recommended PCB layouts see www.samtec.com?RU8

CONNECTOR

Insulator Material:

Black LCP

Contact:

BeCu

Plating:

Au or Sn over

50 μm (1.27 μm) Ni

Current Rating:

3.1 A per pin

(6 adjacent pins powered)

Operating Temp:

-55 °C to +125 °C

PROCESSING

Lead-Free Solderable:

Yes

SMT Lead Coplanarity:

(0.10 mm) .004" max (40-60)

RoHS Compliant:

Yes

RECOGNITIONS

For complete scope of recognitions see

www.samtec.com/quality

Note: While optimized for 50 Ω applications, this connector with alternative signal/ground patterns may also perform well in certain 75 Ω applications.

RU8	1	POSITIONS PER ROW	STACK HEIGHT	SIGNAL ROUTING	PLATING OPTION	DV	BL	OTHER OPTION
		40, 50, 60	-19 = (19 mm) .748" -25 = (25 mm) .984" -30 = (30 mm) 1.180"	-SE = Single-Ended -DP = Differential Pair	-L = 10 μm (0.25 μm) Gold on contact, Matte Tin on tail (Plating for connectors) Plating for Card is Hard Gold		-BL = Board Locks (Bottom Socket only) (Not available on -19 stack height)	Leave blank for Trays -K = (5.50 mm) .217" DIA Polyimide Film Pick & Place Pad -TR = Tape & Reel

Kit contains two connectors and one card. Assembly required.

NO. OF POSITIONS PER SIDE	A	B	-SE TOTAL SIGNAL LINES	-DP TOTAL SIGNAL PAIRS
40	(39.80) 1.567	(51.05) 2.010	40	26
50	(47.80) 1.882	(59.05) 2.325	50	32
60	(55.80) 2.197	(67.05) 2.640	60	38

Note: Other Gold plating options available.

Note: Some lengths, styles and options are non-standard, non-returnable.

Mates with:

HSEC8

SPECIFICATIONS

For complete specifications see www.samtec.com?HSC8

Conductor:

1/2 oz Copper

Contact Area:

Hard Gold Plated

Insulator: FR-4

RoHS Compliant:

Yes

NO. OF POSITIONS PER SIDE	-SE TOTAL SIGNAL LINES	-DP TOTAL SIGNAL PAIRS
-40	40	26
-50	50	32
-60	60	38

Note:

Some sizes, styles and options are non-standard, non-returnable.

HSC8	NUMBER OF POSITIONS PER SIDE	CARD STYLE	STACK HEIGHT	SIGNAL ROUTING
	-040, -050, -060	-02 = (1.60 mm) .062" thick card	-19 = (19 mm) .748" -25 = (25 mm) .984" -30 = (30 mm) 1.180"	-SE = Single-Ended -DP = Differential Pair

STACK HEIGHT	A
-19	(14.84) .584
-25	(20.84) .820
-30	(25.84) 1.017

Note: Due to technical progress, all designs, specifications and components are subject to change without notice.

WWW.SAMTEC.COM

All parts within this catalog are built to Samtec's specifications.

Customer specific requirements must be approved by Samtec and identified in a Samtec customer-specific drawing to apply.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9